



2024年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

2023年11月9日

上場会社名 芝浦メカトロニクス株式会社 上場取引所 東
コード番号 6590 URL <https://www.shibaura.co.jp>
代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 今村 圭吾
問合せ先責任者 (役職名) 取締役 専務執行役員経営管理本部長 (氏名) 池田 賢一 TEL 045-897-2425
四半期報告書提出予定日 2023年11月13日 配当支払開始予定日 —
四半期決算補足説明資料作成の有無：有（当社ウェブサイトに決算説明資料を掲載予定です。）
四半期決算説明会開催の有無：有（機関投資家・アナリスト・メディア向け）

（百万円未満切捨て）

1. 2024年3月期第2四半期の連結業績（2023年4月1日～2023年9月30日）

（1）連結経営成績（累計）

（%表示は、対前年同四半期増減率）

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2024年3月期第2四半期	30,511	4.3	5,016	9.1	5,033	18.2	3,874	13.5
2023年3月期第2四半期	29,256	33.5	4,599	149.1	4,258	143.8	3,414	354.2

（注）包括利益 2024年3月期第2四半期 4,104百万円（13.0%） 2023年3月期第2四半期 3,632百万円（301.8%）

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
2024年3月期第2四半期	292.45	—
2023年3月期第2四半期	257.56	—

（注）当社は、2023年10月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり四半期純利益を算定しております。

（2）連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
2024年3月期第2四半期	87,167	33,785	38.8	2,569.81
2023年3月期	81,887	33,007	40.3	2,488.89

（参考）自己資本 2024年3月期第2四半期 33,785百万円 2023年3月期 33,007百万円

（注）当社は、2023年10月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり純資産を算定しております。

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2023年3月期	—	0.00	—	560.00	560.00
2024年3月期	—	0.00	—	—	—
2024年3月期（予想）	—	—	—	165.00	—

（注）1. 直前に公表されている配当予想からの修正の有無：有

2. 当社は、2023年10月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。2024年3月期（予想）の1株当たり期末配当金については、当該株式分割の影響を考慮した金額を記載し、年間配当金合計は「—」と記載しております。なお、当該株式分割を考慮しない場合の2024年3月期（予想）の期末配当金は495円00銭、年間配当金合計は495円00銭となります。

3. 2024年3月期の連結業績予想（2023年4月1日～2024年3月31日）

（%表示は、対前期増減率）

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属 する当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	65,000	6.6	10,000	△8.3	9,700	△7.7	7,200	△21.7	543.50

（注）1. 直前に公表されている業績予想からの修正の有無：有

2. 当社は、2023年10月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。2024年3月期（予想）における通期の1株当たり当期純利益については、当該株式分割を考慮した金額を記載しております。なお、当該株式分割を考慮しない場合の1株当たり当期純利益は1,630.50円となります。

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）：無

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用：無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む）	2024年3月期2Q	13,971,900株	2023年3月期	15,577,857株
② 期末自己株式数	2024年3月期2Q	824,661株	2023年3月期	2,316,042株
③ 期中平均株式数（四半期累計）	2024年3月期2Q	13,247,496株	2023年3月期2Q	13,256,316株

（注）当社は、2023年10月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、「期末発行済株式数」、「期末自己株式数」及び「期中平均株式数」を算定しております。

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に掲載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する主旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等については、添付資料P. 3「1. 当四半期決算に関する定性的情報（3）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	2
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	3
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	4
(1) 四半期連結貸借対照表	4
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	6
四半期連結損益計算書	
第2四半期連結累計期間	6
四半期連結包括利益計算書	
第2四半期連結累計期間	7
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	8
(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	9
(継続企業の前提に関する注記)	9
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	9
(セグメント情報等)	9
(重要な後発事象)	11

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

①業績全般について

当第2四半期連結累計期間における当社グループの事業環境は、スマートフォン、パソコンの需要低下などを受け、半導体業界においてはメモリ向けを中心に設備投資の減速が見られ、FPD (Flat Panel Display) 業界においては全般的に設備投資が低調な状況が継続しました。その一方で、半導体業界においてIoT、5G、AIなどの需要は引き続き底堅く、ロジック/ファウンドリ向け、パワーデバイス向け、及びウェーハ向けなどの設備投資がいずれも堅調に推移しました。また、いずれの業界においても部品や部材の供給が不安定な状況が続きました。

このような環境の中、当第2四半期連結累計期間の業績は、売上高は、前年同期に比べ半導体分野では増加、FPD分野では減少し、全体では30,511百万円（前年同期比4.3%増）となりました。利益面では、研究開発の強化などによる販売費及び一般管理費の増加があったものの、半導体前工程の売上増加により営業利益が5,016百万円（前年同期比9.1%増）、為替の影響もあり、経常利益が5,033百万円（前年同期比18.2%増）、親会社株主に帰属する四半期純利益が3,874百万円（前年同期比13.5%増）となりました。

なお、受注高は、半導体分野は全体として堅調に推移したものの、顧客の設備投資時期の見直しなどにより、高水準であった前年同期に比べ減少しました。一方FPD分野は低調に推移しました。この結果、当第2四半期連結累計期間における受注高は33,258百万円（前年同期比29.9%減）となりました。

②セグメントの業績について

主な事業セグメントの業績は次のとおりです。

(ファインメカトロニクス部門)

売上高は、半導体前工程ではロジック/ファウンドリ向け装置及びウェーハ向け装置がいずれも順調に推移し、前年同期に比べ増加しました。一方FPD前工程は低調で、前年同期に比べ減少しました。この結果、部門全体では前年同期に比べ増収となり、23,621百万円（前年同期比27.3%増）となりました。

セグメント利益は、半導体前工程での売上増加により4,968百万円（前年同期比55.3%増）となりました。

なお、受注高は、半導体前工程では全体として堅調に推移したものの、顧客の設備投資時期の見直しなどにより、特に好調であった前年同期に比べ減少しました。FPD前工程では市況の影響を受け低調に推移しました。この結果、部門全体では前年同期に比べ受注高が減少し、20,014百万円（前年同期比44.0%減）となりました。

(メカトロニクスシステム部門)

売上高は、半導体後工程では前年同期に比べ減少しましたが、その中でも先端パッケージ向け装置は堅調に推移しました。FPD後工程では、前年度、特に後半の受注が低調だったことを受け前年同期に比べ減少しました。真空応用装置は、半導体分野向けが堅調に推移し前年同期に比べ増加しました。この結果、部門全体では前年同期に比べ減収となり、4,681百万円（前年同期比45.7%減）となりました。

セグメント利益は、半導体後工程及びFPD後工程の売上減少の影響により、359百万円（前年同期比76.0%減）となりました。

なお、受注高は、半導体後工程では生成AI用GPUの需要増に伴い先端パッケージ向け装置が前年同期及び前年下期に比べ大幅に増加しました。FPD後工程では市況の影響を受け、前年同期に比べ大幅に減少しました。真空応用装置では、半導体分野向けを中心に順調に推移しました。この結果、部門全体では前年同期に比べ受注高が増加し、10,323百万円（前年同期比8.2%増）となりました。

(2) 財政状態に関する説明

①資産、負債及び純資産の状況

当第2四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ5,280百万円増加し87,167百万円となりました。これは主に、現金及び預金が1,427百万円、受取手形、売掛金及び契約資産が1,175百万円、建設仮勘定が1,347百万円増加したことによるものです。

負債は、前連結会計年度末に比べ4,501百万円増加し53,382百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が2,065百万円、前受金が1,387百万円増加したことによるものです。

純資産は、前連結会計年度末に比べ778百万円増加し33,785百万円となりました。

②キャッシュ・フローの状況

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前連結会計年度末に比べ1,427百万円増加し、28,588百万円となりました。

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動による資金の増加は5,114百万円（前年同期は5,173百万円の増加）となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益の計上、前受金の増加、仕入債務の増加により資金が増加し、一方で棚卸資産の増加、法人税等の支払で資金が減少したことによるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動による資金の減少は478百万円（前年同期は792百万円の減少）となりました。これは主に、固定資産の取得により資金が減少したことによるものです。

なお、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合わせたフリー・キャッシュ・フローは、4,636百万円の増加（前年同期は4,381百万円の増加）となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動による資金の減少は3,349百万円（前年同期は2,327百万円の減少）となりました。これは主に、自己株式の取得及び配当金の支払いにより資金が減少したことによるものです。

（3）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

業績予想の修正につきましては、本日（2023年11月9日）公表しました「2024年3月期 通期連結業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。

なお、本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、公表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績等は今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2023年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	27,175	28,603
受取手形、売掛金及び契約資産	31,844	33,019
電子記録債権	799	844
商品及び製品	1,376	2,066
仕掛品	4,935	5,339
原材料及び貯蔵品	200	321
未収入金	2,203	1,661
その他	315	585
貸倒引当金	△1,440	△1,232
流動資産合計	67,409	71,208
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	28,572	28,876
減価償却累計額	△20,489	△20,697
建物及び構築物（純額）	8,082	8,178
機械装置及び運搬具	7,401	8,019
減価償却累計額	△5,308	△5,682
機械装置及び運搬具（純額）	2,092	2,336
工具、器具及び備品	1,366	1,488
減価償却累計額	△1,117	△1,181
工具、器具及び備品（純額）	248	306
土地	119	119
リース資産	96	147
減価償却累計額	△63	△73
リース資産（純額）	33	73
建設仮勘定	1,086	2,433
有形固定資産合計	11,663	13,449
無形固定資産		
特許権	388	400
その他	216	180
無形固定資産合計	604	581
投資その他の資産		
投資有価証券	0	0
長期前払費用	12	12
繰延税金資産	1,984	1,690
その他	214	226
貸倒引当金	△1	△1
投資その他の資産合計	2,211	1,928
固定資産合計	14,478	15,959
資産合計	81,887	87,167

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2023年9月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	11,518	13,583
電子記録債務	3,897	4,422
短期借入金	3,750	3,750
1年内返済予定の長期借入金	—	2,200
リース債務	16	22
未払法人税等	1,684	1,139
未払費用	3,926	4,262
前受金	8,099	9,487
役員賞与引当金	146	56
製品保証引当金	108	128
その他	846	1,805
流動負債合計	33,995	40,858
固定負債		
長期借入金	5,000	2,800
リース債務	20	54
退職給付に係る負債	6,380	6,172
役員退職慰労引当金	28	30
修繕引当金	310	320
資産除去債務	67	67
長期預り保証金	3,078	3,078
固定負債合計	14,885	12,524
負債合計	48,880	53,382
純資産の部		
株主資本		
資本金	6,761	6,761
資本剰余金	9,037	6,939
利益剰余金	20,944	21,667
自己株式	△3,998	△2,074
株主資本合計	32,745	33,293
その他の包括利益累計額		
為替換算調整勘定	535	687
退職給付に係る調整累計額	△274	△195
その他の包括利益累計額合計	261	492
純資産合計	33,007	33,785
負債純資産合計	81,887	87,167

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
 (四半期連結損益計算書)
 (第2四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
売上高	29,256	30,511
売上原価	18,505	18,379
売上総利益	10,750	12,132
販売費及び一般管理費	6,151	7,115
営業利益	4,599	5,016
営業外収益		
受取利息	1	8
受取配当金	0	0
為替差益	486	461
その他	32	102
営業外収益合計	521	572
営業外費用		
支払利息	41	35
デリバティブ評価損	723	312
その他	96	206
営業外費用合計	861	555
経常利益	4,258	5,033
税金等調整前四半期純利益	4,258	5,033
法人税、住民税及び事業税	834	866
法人税等調整額	9	292
法人税等合計	844	1,159
四半期純利益	3,414	3,874
親会社株主に帰属する四半期純利益	3,414	3,874

(四半期連結包括利益計算書)
(第2四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
四半期純利益	3,414	3,874
その他の包括利益		
為替換算調整勘定	161	151
退職給付に係る調整額	56	78
その他の包括利益合計	218	230
四半期包括利益	3,632	4,104
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	3,632	4,104

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益	4,258	5,033
減価償却費	849	1,076
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△127	△208
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	△46	△129
受取利息及び受取配当金	△1	△8
支払利息	41	35
為替差損益 (△は益)	25	37
前受金の増減額 (△は減少)	2,761	1,239
売上債権の増減額 (△は増加)	△1,103	△1,142
棚卸資産の増減額 (△は増加)	△1,654	△2,236
仕入債務の増減額 (△は減少)	894	2,516
未収入金の増減額 (△は増加)	560	542
その他	△145	25
小計	6,312	6,781
利息及び配当金の受取額	1	8
利息の支払額	△43	△35
法人税等の支払額	△1,097	△1,639
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,173	5,114
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△699	△402
その他	△92	△76
投資活動によるキャッシュ・フロー	△792	△478
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の返済による支出	△500	—
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△8	△11
長期借入金の返済による支出	△800	—
自己株式の取得による支出	△0	△860
配当金の支払額	△1,017	△2,477
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,327	△3,349
現金及び現金同等物に係る換算差額	170	140
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	2,224	1,427
現金及び現金同等物の期首残高	26,301	27,160
現金及び現金同等物の四半期末残高	28,526	28,588

(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

(1) 自己株式の消却

当社は、2023年5月11日開催の取締役会決議に基づき、2023年5月31日付で自己株式535,319株の消却を実施いたしました。この結果、当第2四半期連結累計期間において資本剰余金が2,098百万円、利益剰余金が674百万円、自己株式が2,772百万円減少しております。

(2) 自己株式の取得

当社は、2023年8月22日開催の取締役会決議に基づき、2023年9月22日に東京証券取引所の自己株式立会外買付取引 (ToSTNeT-3) により、自己株式41,600株の取得を行いました。この結果、当第2四半期連結累計期間において自己株式が859百万円増加しております。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

I 前第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

	報告セグメント				合計
	ファインメカトロニクス	メカトロニクスシステム	流通機器システム	不動産賃貸	
売上高					
外部顧客への売上高	18,556	8,620	1,147	931	29,256
セグメント間の内部売上高又は振替高	25	121	0	45	192
計	18,582	8,742	1,147	977	29,449
セグメント利益	3,199	1,495	35	245	4,975

2. 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容 (差異調整に関する事項)

(単位：百万円)

利益	金額
報告セグメント計	4,975
全社費用 (注)	△396
その他	△320
四半期連結損益計算書の経常利益	4,258

(注) 全社費用は、報告セグメントに帰属しない当社の研究開発費のうち全社共通に係る要素開発費用であります。

3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

II 当第2四半期連結累計期間(自2023年4月1日至2023年9月30日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)

	報告セグメント				合計
	ファインメカ トロニクス	メカトロニク スシステム	流通機器 システム	不動産賃貸	
売上高					
外部顧客への売上高	23,621	4,681	1,311	896	30,511
セグメント間の内部売上高又は振替高	25	114	—	46	186
計	23,647	4,795	1,311	943	30,698
セグメント利益	4,968	359	92	189	5,609

2. 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:百万円)

利益	金額
報告セグメント計	5,609
全社費用(注)	△584
その他	8
四半期連結損益計算書の経常利益	5,033

(注) 全社費用は、報告セグメントに帰属しない当社の研究開発費のうち全社共通に係る要素開発費用であります。

3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。

(重要な後発事象)

(株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更)

当社は、2023年5月11日開催の取締役会決議に基づき、2023年10月1日付で株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更を行っております。

1. 株式の分割について

(1) 分割の目的

株式の分割によって投資単位を引き下げ、投資家の皆様により投資しやすい環境を整えることにより、投資家層の拡大を図ることを目的としております。

(2) 分割の方法

2023年9月30日(土曜日)(当日は株主名簿管理人の休業日のため、実質的には2023年9月29日(金曜日))を基準日として、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有する当社普通株式を、1株につき3株の割合をもって分割しております。

(3) 分割により増加する株式数(注)

分割前の発行済株式総数	4,657,300株
分割により増加する株式数	9,314,600株
分割後の発行済株式総数	13,971,900株
分割後の発行可能株式総数	30,000,000株

(注) 分割前の発行済株式総数は、2023年5月31日に実施の自己株式の消却後における株式数であり、分割により増加する株式数及び分割後の発行済株式総数は、これを基に算出しております。

(4) 分割の日程

基準日公告日	2023年9月15日(金曜日)
基準日	2023年9月30日(土曜日)
効力発生日	2023年10月1日(日曜日)

(5) 1株当たり情報に及ぼす影響

1株当たり情報に及ぼす影響については、当該箇所に記載しております。

2. 定款の一部変更について

(1) 変更の理由

上記株式分割に伴い、会社法第184条第2項の規定に基づき、2023年10月1日(日曜日)を効力発生日として、当社定款第6条の発行可能株式総数を変更しております。

(2) 変更の内容

(下線は変更部分を示します。)

変更前	変更後
(発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式総数は <u>1</u> 千万株とする。	(発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式総数は <u>3</u> 千万株とする。

3. 資本金の額の変更について

上記株式分割による資本金の額の変更はありません。